

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 投资者关系活动类别     | <div>■特定对象调研                      □分析师会议</div> <div>□媒体采访                          □业绩说明会</div> <div>□新闻发布会                        □路演活动</div> <div>□现场参观                          □电话会议</div> <div>□其他</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
| 日期/时间         | 2025 年 5 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地点 | 会议室 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、2025 年一季度毛利率提升至 37.19%，主要驱动因素是什么？</p> <p>公司回答：公司 2025 年一季度毛利率同比提升约 3 个百分点，主要原因是随着前几年的战略布局，公司产品结构发生了变化，2-5 节 BMS、PPG 新产品出货量较上年同期翻番增长，传统业务占比较上期有所下降，产品结构优化使得毛利率同比增长。</p> <p>2、请问公司在人形机器人或电子皮肤相关产品中具有什么布局吗？</p> <p>公司回答：人形机器人对半导体的集成度、智能化和感知水平提出了更高要求。在机器人领域，围绕电子皮肤、六维力传感器等关键应用，公司已与相关客户展开探索与合作。例如，ADC 是电子皮肤的底层技术之一，高精度 ADC 能将微小压力变化精准数字化，避免信号模糊。芯海 ADC 具有高精度、高线性度、低温漂等特性，且布局广泛、应用场景众多。机器人的感知、决策、执行等动作需要电子皮肤、六维力传感器、空心杯电机等设备作为基础桥梁，而这些设备的精确运转离不开对应的高精度 ADC、MCU、触觉反馈芯片、传感器调理芯片、压力触控芯片等硬件的支持。</p> <p>3、公司在 PC 业务的布局规划？产品的核心竞争力来自于哪里？</p> <p>公司回答：AI 带来算力需求迅猛增长，带来了满足海量数据计算的高性能处理器芯片需求，公司基于自身深厚的技术积累，已实现了以 EC 为核心，覆盖 PD、HapticPad、</p> |    |     |

USB 3.0 HUB、BMS 的横向产品布局；同时，也完成了从 AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务服务器的 EC、SIO、edge BMC 的纵向产品布局。公司 EC 是大陆首个通过 Intel 国际认证的 EC 产品，同时也通过了计算机全球龙头企业验证，打破了海外产品对于此市场的垄断，能够满足各种品类计算机的需求，目前已经完成和国内外各大主流笔记本厂家的适配工作。荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于报告期内发布，该产品搭载了芯海科技高性能 EC 芯片；USB 3.0 HUB 产品已在客户端实现量产；应用于台式计算机的第一代 Super IO 产品已经导入客户端。截至 2024 年年末，EC 累计出货量近 1,000 万颗。

随着 AI 大模型的衍生应用不断推出，许多终端开始升级智能化体验，从而产生了海量的终端数据分析处理需求。企业的业务部署场景和数据产生正在向端侧、边缘侧“迁移”。公司针对边缘计算及服务服务器市场的轻量级 edge BMC 管理芯片，已经上市并开始导入客户端。

公司凭借 20 余年高精度 ADC 技术积累及高可靠性 MCU 技术壁垒，构建了覆盖从计算机到服务器领域的全系列产品，并进入荣耀、Intel 等国内及全球头部客户供应链。通过“感知+计算+连接+算法”全栈技术整合和生态协同，形成深度客户黏性。未来，公司仍将坚持以“驱动计算、服务计算”为方向，助力 PC 从“生产力工具”进化为“智能伙伴”，与行业伙伴共同开启 AI 时代 PC 的无限可能。

**4、公司目前产品中哪些具备国产替代能力？**

公司回答：公司一直积极拓展符合公司战略发展方向的国内外客户。公司多款芯片成功实现了国产替代，比如高精度 ADC 芯片，EC 系列芯片，PD 芯片，BMS 芯片，传感器调理芯片等。公司从 2003 年成立以来，一直聚焦在信号链领域的设计研发，拥有高精度 ADC、高可靠性 MCU 等核心技术。

**5、用于手机侧边按键的触觉反馈芯片目前实现了向哪些手机品牌的销售？**

公司回答：自 2016 年开始进行压力触控芯片及应用研发，芯海压感产品历经初代到第四代，不断突破技术瓶颈，为用户带来了更加卓越的交互体验。目前公司压力触控芯片已经在 OPPO Find X8、vivo X200 Ultra 系列实现销售。

**6、鸿蒙生态布局是否带来增量？**

公司回答：鸿蒙是芯海的生态合作伙伴。芯海注重技术创新和研发投入，在能力、产品、商业布局上的突出亮点包括强大的模拟芯片和 MCU 设计能力，以及针对物联

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>网市场的全面解决方案，基于此，公司持续向轻量级设备领域厂商提供具有市场竞争力的创新产品。此外，作为轻量级设备领域与鸿蒙生态互联互通的桥梁，公司不仅提供产品，还提供使能服务，帮助中小企业更好地融入鸿蒙生态。通过软硬服务一体化与鸿蒙合作，在开源鸿蒙中参与标准建设及共创，例如智能仪表产品的出货量稳定上升。随着鸿蒙连接数和品类的不断增长和扩展，我们看到鸿蒙生态系统正在不断壮大和完善。</p> <p>截至 2024 年末，公司已成功导入 300 余个鸿蒙智联项目商机，完成 115 个 SKU 的产品接入，终端产品累计出货量近 4,000 万台。在电力细分市场，公司通过了电鸿模组认证。2025 年，公司成功进入“鸿蒙智联推荐模组”名单。</p> <p><b>7、公司在 AI 落地方面有什么新的战略布局吗？</b></p> <p>公司回答：在云端，芯海科技和子公司康柚健康希望与合作伙伴一起，以芯片与算法为核心优势，借助 AI 大模型进行数据分析，预测和评估千万用户的健康状况，为用户推送健康信息前瞻提示，助力运动与饮食干预，推动健康生活方式养成。</p> <p>在边缘端，智能边缘设备与 AI 技术逐步融合。边缘 AI 离客户更近，出于数据隐私与资产保护考量，众多企业用户不愿将数据传至云端，倾向私有化部署数据中心，边缘 AI 正好契合这一需求。能实现定制化、个性化，以低时延、高响应特性，更好匹配场景要求。</p> <p>在应用终端，AI 技术赋予了各种终端设备更智能化的特性，作为重要的生产力工具，AI 应用的落地需要硬件的承载，与各行各业结合，赋能千行百业。在智能汽车、人形机器人、工业物联网、医疗健康等领域，行业应用爆发，从“万物互联”迈向“万物智联”。各类新型智能终端的快速发展，催生了万亿级芯片增量市场，芯片功能从“通用化”转向“场景定制化”。</p> <p>公司将加大 AI 技术方面投入，结合 ADC、MCU 双平台优势，围绕通信与计算机、机器人、工业高精度测量和汽车等方向布局。公司积极配合 AI 技术落地不断创新，围绕“云边端”协同和落地，与下游生态深度绑定，为垂直场景提供“芯片+算法+数据”全栈方案，力求在市场中占据领先地位，实现企业的快速发展。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 以下本次活动参与人员签字页 |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 参与单位名称        | 天风证券、国投证券、华龙证券、太平洋资产管理、国泰基金、招商基金、西部利得基金、工银瑞信基金、兴银理财、华泰资管、和君资本、国鸣投资 |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书：张娟苓女士                                                        |